



Flux en gel IF 8300

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique série IF 8300
Ver: 3.11 28-09-15

Page 1

Flux en gel sans nettoyage, sans halogènes.

Description:

Interflux® IF 8300 est un flux en gel sans nettoyage, sans halogènes et sans colophane avec un résidu minimal après le brasage.

Le flux possède des propriétés comme celles des résines. Il est disponible en plusieurs viscosités pour plusieurs applications.

La série des flux en gel **IF 8300** peut être appliquée par sérigraphie, par seringue ou par pinceau.

La série des flux en gel **IF 8300** est compatible avec des alliages sans et avec plomb.

Le flux a un excellent mouillage sur pratiquement toutes les finitions: OSP (cuivre passivé), NiAu, I-Sn...etc.

Les résidus sont minimaux et transparents et n'exigent pas de nettoyage.

Propriétés



La photo n'est pas contractuelle

Propriétés physiques et chimiques :

Etat	: visqueux
Couleur	: jaune
Odeur	: Odeur douce
Présence d'halogènes	: Aucune
pH (5% aq.sol)	: 3
IPC/ EN	: RE L0

	IF 8300	IF 8300-4	IF 8300-6
--	---------	-----------	-----------

Point éclair	158 °C	144 °C	137 °C
Solubilité dans l'eau	insoluble	insoluble	insoluble
Point d'auto-inflammation	> 370 °C	> 370 °C	> 370 °C
Poids spécifique	1,032 g/ml	1,020 g/ml	1,013 g/ml
Viscosité à 20 °C	± 210.000 cPs	± 70.000 cPs	± 25.000 cPs



Informations complémentaires :

Profil de refusion	2
Recommandations sur le profil—alliages sans Pb	2
Recommandations sur le profil—alliages SnPb & SnPbAg	3
Tests de fiabilité	4

Avantages:

- Absolument sans halogènes
- Sans colophane
- Bon mouillage sur I-Sn, Ni/Au, OSP (cuivre passivé), Ag/Pd
- Résidu minimal

Profil de refusion

Description Générale

Les profils de refusion linéaires ou avec un palier sont possibles. Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants ou bien pour di-

minuer ou éliminer la présence de « voids ». Avec la refusion par convection il faut atteindre le pic de refusion à 300s du début du profil. La bonne vitesse du convoyeur peut être calculée en divisant la longueur totale des zones de chauffage par la durée désirée du profil.

Quand vous brasez une carte avec un four à refusion, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une

bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

Recommandations sur le profil en alliages SAC et SnAg

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 200°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

Palier

A partir de 180°C jusqu'à environ 215°C avec une pente de 0-1°C/seconde. Dans certains cas un palier avec une température stable est utilisé pour rendre homogène les différences de températures sur la carte ou

afin de réduire la présence de "voids". Pour cela, généralement un palier de 20s à 90s. entre 200°C et 215°C est utilisé.

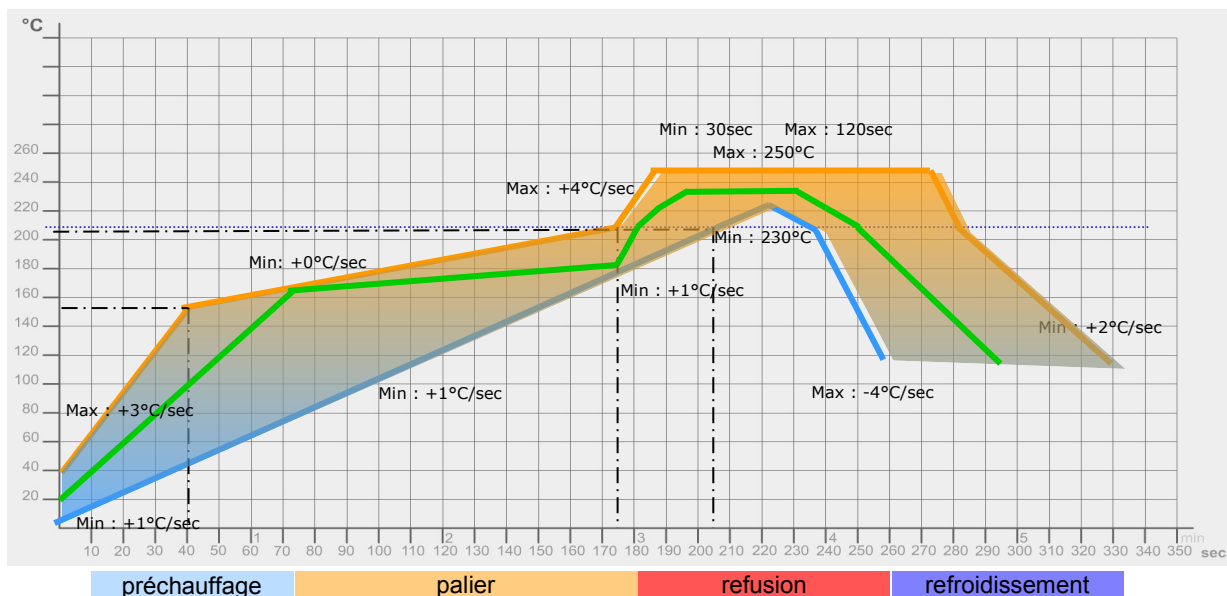
235°C et 250°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.

Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre



Recommandations sur le profil en alliages SnPb & SnPbAg

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 170°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

Palier

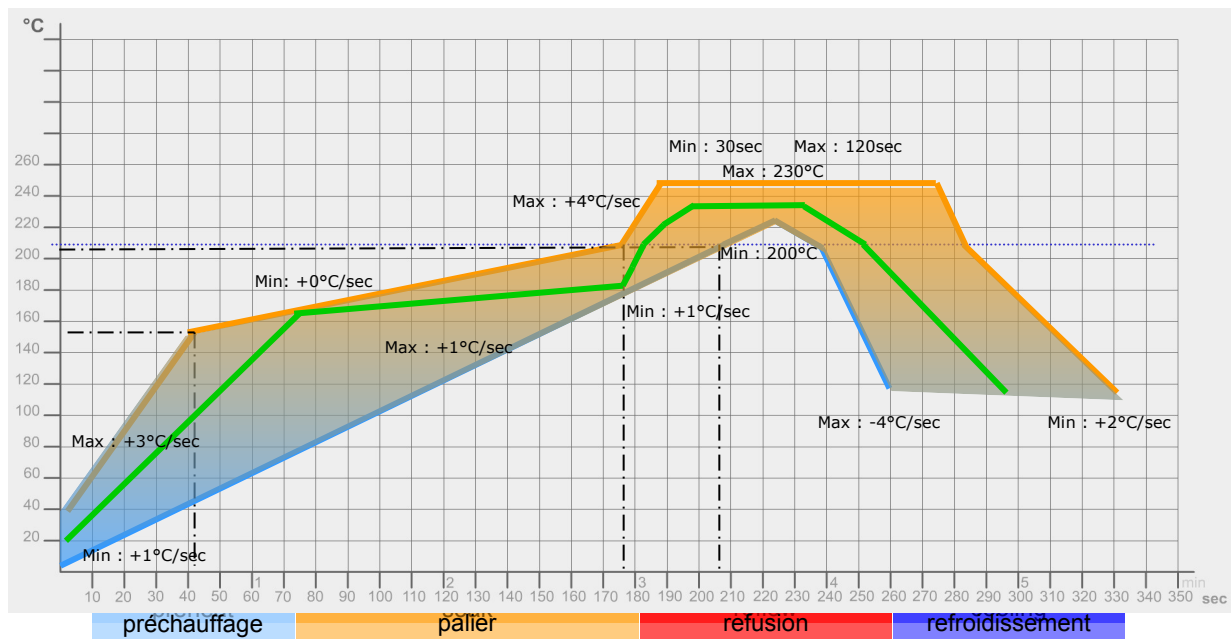
A partir de 120°C jusqu'à environ 170°C avec une pente de 0-1°C/s, un palier de 20s à 90s est souvent utilisé pour rendre homogène les différences de températures sur la carte ou afin de réduire la présence de "voids".

Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre 200°C et 230°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.





Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Indice d'acidité par titration	28,9	mg KOH/g
Environnement		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Conditionnements

La série de flux en gel IF 8300 est disponible dans les conditionnements suivants:

IF8300

Seringue de 5cc sans et avec poussoir
Seringue de 10 cc sans et avec poussoir
Seringue de 30 cc sans et avec poussoir
Pot de 30 cc
Pot de 100 cc
Cartouche de 310 cc
Seau de 1 kg

IF8300-4

Pot de 30cc avec pinceau
Seau de 1kg

IF8300-6

Pot de 30cc avec pinceau
Seau de 1kg

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com